

Siconnex Japan、ウェビナー開催を発表：ウェットエッチングの未来－効率、安全性、環境コンプライアンス

Siconnex は、愛知工業大学、テクニクジャパンと共同で、2025 年 11 月 28 日、ウェットエッチング・レジスト剥離プロセスの技術革新についてのウェビナーを実施します。

Siconnex Japan 合同会社は、「ウェットプロセス最前線～ウェットエッチングの基礎と環境対応、レジスト剥離との統合」と題した無料専門ウェビナーの開催を発表しました。このオンラインイベントは、2025 年 11 月 28 日（金）15:00 から 16:30（日本標準時）まで開催され、半導体および電子デバイス製造の専門家を対象としています。

ウェットエッチングは、ドライエッチングと比較して「古い技術」と見なされがちですが、現代の製造において不可欠な標準プロセスであり続けています。技術開発も進んでおり、特に環境適合性と労働安全衛生（EHS）が重要なテーマとして浮上しています。

本ウェビナーでは、ウェットエッチングの基礎、またエッチングプロセスに続いて行われるレジスト剥離プロセスと併せて装置や化学薬品における最新の技術革新に焦点を当て、プロセスの効率化を図りつつ、安全性を高め、環境負荷を低減する取り組みを紹介します。

ウェビナーの詳細については、siconnex.com/ja をご覧ください。

Company info

Siconnex is one of the leading suppliers of wet chemistry equipment for etch, clean, and resist strip applications. The company's main headquarters and production facilities are located in Austria, with additional sites in America, Japan, Malaysia, Singapore, and France.

With over 20 years of experience, Siconnex has fully dedicated its efforts to perfecting batch spray technology—the core technology known as BATCHSPRAY®. This technology exemplifies our commitment to reducing environmental impact while maintaining high performance and efficiency.

We believe that sustainability and technological progress go hand in hand, and we combine them in our systems. As a hidden champion, we perform essential work for technology-leading companies and have a significant impact on microchip production worldwide.

For more information, please visit our Japanese website at www.siconnex.com/ja